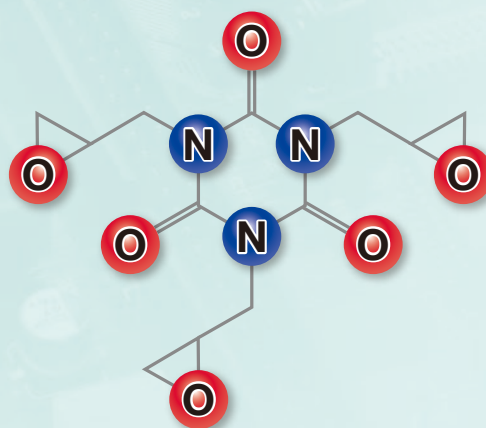


## TEPIC



## ● 特長 Characteristics

## ■ 透明性、耐熱性、耐光性

High transparency, high heat resistance, and high light resistance

## ■ 高弾性率

High modulus

## ■ 高Tg

High Tg

## ● グレード Grade

品 番 Grade	TEPIC-S	TEPIC-SS	TEPIC-SP	TEPIC-HP
特 長 Characteristics	基本グレード Basic grade	低塩素 Low chlorine	小粒径 Small particle	高融点 High melting point
外観 Appearance	粉体 Powder	粉体 Powder	微粉 Fine Powder	微粉 Fine Powder
粒径 (μm) Particle size	<350	<350	<3 (Median) Approx.10 (Max)	<5 (Median) Approx.20 (Max)
融点 (°C) Melting Point	98-120	98-120	98-120	153-157
エポキシ当量 (g/eq) Epoxy equivalent ratio	<105	<105	<105	<102
塩素 (ppm) Chlorine	<850	<300	<850	<250

## ● 硬化物物性 Property of thermosetting resin

項 目 Item	TEPIC-S	ビス A 型エポキシ <sup>1)</sup> BPA epoxy	脂環式エポキシ <sup>2)</sup> Alicyclic epoxy
Tg (°C) <sup>3)</sup>	245	166	240
曲げ強度 (MPa) Flexural strength	135	122	128
たわみ量 (mm) Flexural length	9	27	11
曲げ弾性率 (MPa) Flexural modulus	3,840	2,920	3,400
線膨張係数 (ppm/°C) CTE	71	68	74

&lt;硬化条件&gt;

硬 化 剤：リカシッド MH-700 (新日本理化学株式会社)、硬化促進剤：ヒシコーリン PX-4ET (日本化学工業株式会社) 1phr

硬化時間：150℃

1) JER828 (三菱ケミカル株式会社)、2) セロキサイド 2021P (株式会社ダイセル)、3) DMA により測定

## ● 主な用途 Application

## ■ LED 周辺材料 (透明封止材、リフレクター材)

Transparent encapsulant or reflector for LED

## ■ ソルダーレジストインキ

Solder resist ink

## ■ 粉体塗料硬化剤

Curing agent for powder coating

## ■ CFRP マトリクス樹脂

Matrix resin for CFRP

記載の数値は代表値です。保証値ではありません。

